

日月光一〇六年度第三季業績簡訊

日月光半導體於台灣時間 106 年 10 月 27 日同步於美國及台灣兩地發佈一〇六年度第三季獲利報告，本公司一〇六年第三季之合併營業收入較一〇六年第二季成長 12%，較一〇五年同期成長 2%，為新台幣 73,878 百萬元。茲將日月光一〇六年度第三季單季之合併營運成果、產品結構及其銷售地區比重表列如下：

合併綜合損益表（單位：新台幣百萬元）

項 目	106 年度 第三季	106 年度 第二季	105 年度 第三季	106 年度 前三季	105 年度 前三季
營業收入淨額	73,878	66,026	72,784	206,455	197,756
營業毛利	13,848	12,116	14,111	37,939	37,813
營業淨利（淨損）	7,068	5,219	7,436	17,512	18,530
稅前淨利（淨損）	7,815	11,390	6,870	23,050	18,324
所得稅利益（費用）	(1,083)	(3,207)	(976)	(5,176)	(3,817)
非控制權益	(396)	(336)	(392)	(1,132)	(821)
歸屬予本公司業主之淨利（淨損）	6,336	7,847	5,502	16,742	13,686
基本每股盈餘(新台幣元)	0.76	0.97	0.72	2.08	1.79
稀釋每股盈餘(新台幣元)	0.69	0.89	0.64	1.89	1.50

綜合損益表 - 半導體封裝測試（單位：新台幣百萬元）

項 目	106 年度 第三季	106 年度 第二季	105 年度 第三季	106 年度 前三季	105 年度 前三季
營業收入淨額	41,854	39,048	43,006	119,287	117,053
營業毛利	10,486	9,027	10,966	28,346	28,357
營業淨利（淨損）	5,724	4,102	6,190	13,809	14,327
稅前淨利（淨損）	7,205	9,462	6,314	19,874	16,386
所得稅利益（費用）	(784)	(1,541)	(719)	(2,895)	(2,514)
非控制權益	(85)	(74)	(93)	(237)	(186)
歸屬予本公司業主之淨利（淨損）	6,336	7,847	5,502	16,742	13,686

半導體封裝測試銷售分析

產品應用別佔比	%
通訊	49
電腦	10
汽車, 消費性電子及其它	41
前十大客戶佔營收比重	50

測試業務產品組合	%
後段測試	79
晶圓測試	18
前段測試	3
測試資本支出金額	29 百萬美元
測試機台數	3,739 台

封裝業務產品組合	%
Bumping, Flip Chip, WLP & SiP	32
IC Wirebonding	57
Discrete and Others	11
封裝資本支出金額	84 百萬美元
打線機台數	16,083 台

電子代工服務銷售分析

產品應用別佔比	%
通訊	45
電腦	14
消費性電子	26
工業用	8
汽車電子	6
其它	1
前十大客戶佔營收比重	89
EMS 資本支出金額	13 百萬美元

根據對當前業務狀況的評估及匯率的假設，日月光公司 2017 年第四季的業績展望如下：

- 半導體封測事業第四季生意量與毛利率將相當於今年第三季水準；
- 電子代工服務第四季生意量將相當於半導體封測事業今年第四季生意量；
- 電子代工服務第四季毛利率將略高於去年第一季水準。